

EV GROUP Advances Leadership in Optical Lithography With Next-generation EVG150 Resist Processing Platform – November 10, 2022

EV Group透過次世代EVG150光阻製程平台擴大在光學微影領域的領先優勢

本新聞稿已核實 94 次

本新聞稿之內容與之標題皆經華之字通訊所查證，與原本站無關

轉知分享       

經過重新設計的200毫米平台提升模塊數量以達到更高的製程產出。透過架構改善降低設備的佔地面積，同時維持前一代平台引領業界的功能。

台北，2022年11月30日 — 微機電系統 (MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓協會暨微影技術設備領導廠商EV Group (EVG)，今天宣布發表次世代200毫米版本的EVG150自動化光阻製程系統。強化該公司的光學微影解決方案產品組合，重新設計的EVG150平台包括先進功能與強化項目，與前一代平台相比可提供更高的製程產出 (最多產出80%)、通用性，以及更小的設備佔地面積 (減少近50%)。EVG150在通用的平台上提供可靠且高品質的塗佈與顯影製程，可支援各種裝置與應用，包括先進封裝、微機電系統、無線射頻 (RF)、3D感測、功率元件以及光子元件。EVG150極高的製程產出、彈性與再現性，能支援大規模量產與工廠開發所需的晶圓製備。

電子控制系統 (ECS) 產業的頂尖研究中心Silicon Austria Labs是第一個採用次世代EVG150系統的客戶。Silicon Austria Labs微系統研究部門負責人Mohsen Moridi博士表示：「早在工業4.0、物聯網、自動駕駛、虛實整合系統 (CPS)、人工智慧、智慧城市、智慧能源與智慧醫療應用，我們就透過與引領業界的製造業共同研究，開發出奠定上述應用基礎的關鍵技術。EVG的次世代EVG150光阻製程系統的高度彈性，為我們客戶的全新製程與產品的大規模導入打好基礎，並推動ECS的創新。」

通用平台提供前所未有的彈性

為200毫米基板設計的次世代EVG150保有前一代平台引領業界的功能，包括具有全自動化功能的可客製化的旋轉與噴霧式塗佈、顯影、烘烤與冷卻模塊；EVG專有的OmniSpray®技術，可因應複雜形狀的成形塗佈；精密已經現場驗證的機械化處理，與雙末端執行器可確保持續的高製程產出；以及晶圓邊緣、弓形、翹曲及薄化晶圓的處理。

次世代EVG150 200毫米平台的全新功能包括：

- 最多達四個噴霧式製程模塊的空間，以及高達20個供漿/冷卻單元，可以同時處理更多的晶圓。
- 獨立的光阻塗佈腔體使腔體完全隔離，幾乎完全消除模塊間的交互污染。
- 模塊經過進一步重新設計，可在設備外部更容易處理個別腔體，獲得最小的停機時間，且在進行腔體保養時也可持續操作設備。
- 系統內部的腔體重新定義，以便更容易以機械化處理來進行保養。
- 具有影像功能的預對準系統，可以隨時進行晶圓置中進而加速製程。
- 整合系統內部的光阻與化學藥液管理，可以減少儲存化學藥液的外部機櫃空間，並降低設備的佔地面積。
- 將使用者介面整合於系統內，可以進一步降低設備的佔地面積。

EV Group企業技術總監Thomas Glinzner博士表示：「光阻製程與晶圓化是半導體製程中反覆進行最多次的製程步驟。EVG已經針對這些製程累積了多年的經驗，包括光學塗佈、旋轉與噴霧式塗佈，以滿足最嚴苛的客戶需求，我們將這些經驗融入次世代的EVG150系統中。這套系統經全面性的重新設計，可在通用平台上提供突破性的製程產出與擁有成本效益，提供無與倫比的彈性，以滿足最廣泛的光阻製程需求。」

產品供應時程

EVG已經開始接受各界對次世代EVG150自動化光阻製程系統的訂單，並在公司總部提供產品展示。更多相關資訊請參閱：<https://www.evgroup.com/products/lithography/resist-processing-systems/evg150/>

關於EV Group (EVG)

EVG是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程解決方案領導廠商。主要產品包括晶圓蝕刻、晶圓薄化、雷射/紫外光微影技術 (NIL) 和檢測設備，以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG成立於1980年，藉由一個完善的全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站：www.EVGroup.com。